

CC335x SimpleLink™ 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

1 特性

主要特性

- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- CC335x1 器件中的低功耗 Bluetooth® 5.4
- 能够运行 TCP/IP 堆栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC
- 集成 2.4GHz/5GHz PA，适用于输出功率高达 +20.5dBm 的完整无线解决方案。
- 工作温度：-40°C 至 +105°C
- 应用吞吐量高达 50Mbps

扩展特性

- Wi-Fi 6
 - 2.4GHz 和 5GHz、20MHz，单空间流
 - 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
 - OFDMA、触发帧、MU-MIMO (下行链路)、基本服务集着色和目标唤醒时间 (TWT)，可提高效率
 - 基于硬件的加密和解密，支持 WPA2 和 WPA3
 - 出色的互操作性
 - 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
- 低功耗蓝牙 5.4
 - LE 编码 PHY (远距离)、LE 2M PHY (高速) 和广播扩展
 - 主机控制器接口 (HCI) 传输，具有 UART 或共享 SDIO 的选项
- 增强的安全性
 - 安全主机接口
 - 固件身份验证
 - 防回滚保护
- 多角色支持 (例如，并发 STA 和 AP)，可连接不同射频通道 (Wi-Fi 网络) 上的 Wi-Fi 器件
- 可选天线分集或选择
- 3 线或 1 线 PTA，用于与额外 2.4GHz 无线电 (例如 Thread 或 Zigbee) 在外部共存
- 电源管理
 - V_{MAIN} 、 V_{IO} 、 V_{pp} : 1.8V
 - V_{PA} : 3.3V
- 时钟源
 - 40MHz XTAL 快速时钟
 - 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
- 封装尺寸小
 - 易于设计，采用 40 引脚 5mm x 5mm Quad Flat No-Leaded (QFN) 封装，间距为 0.4mm

2 应用

- 电网基础设施
 - 电表
 - 串式逆变器
 - 微型逆变器
 - 能量存储电源转换系统 (PCS)
 - 电动汽车充电基础设施
- 楼宇和家庭自动化
 - HVAC 控制器
 - HVAC 网关
 - 恒温器
 - 楼宇安全网关
 - 车库门系统
 - IP 网络摄像头和可视门铃
 - 无线安防摄像头
- 电器
 - 冰箱和冷冻柜
 - 烤箱
 - 洗衣机和烘干机
 - 住宅热水器和供暖系统
 - 空气净化器和加湿器
 - 咖啡机
 - 空调室内机
 - 扫地机器人
 - 割草机器人
- 医疗
 - 输液泵
 - 电子病床和床控制器
 - 多参数患者监护仪
 - 血压监护仪
 - CPAP 呼吸机
 - 远程保健系统
 - 超声波扫描仪
 - 超声波智能探头
 - 电动牙刷
- 零售自动化和付款
- 打印机



3 说明

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性，可支持工程师放心地连接更多应用。CC33xx 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 器件。CC3350 和 CC3351 是此引脚对引脚兼容系列中的首批双频带器件。

- **CC3350** : 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套 IC
- **CC3351** : 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套 IC

CC335x 提供 Wi-Fi 6 和 BLE，同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。这些 CC335x 器件是德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此，CC335x 基于成熟的技术设计而成。这些器件非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335x 以较小的 PCB 封装尺寸和高度优化的物料清单为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。

器件信息

器件型号	WI-FI 2.4GHz/5GHz SISO	低功耗蓝牙
CC3350ENJARSBR	✓	
CC3351ENJARSBR	✓	✓

4 系统图

图 4-1 展示了 CC3351 的基本系统图。

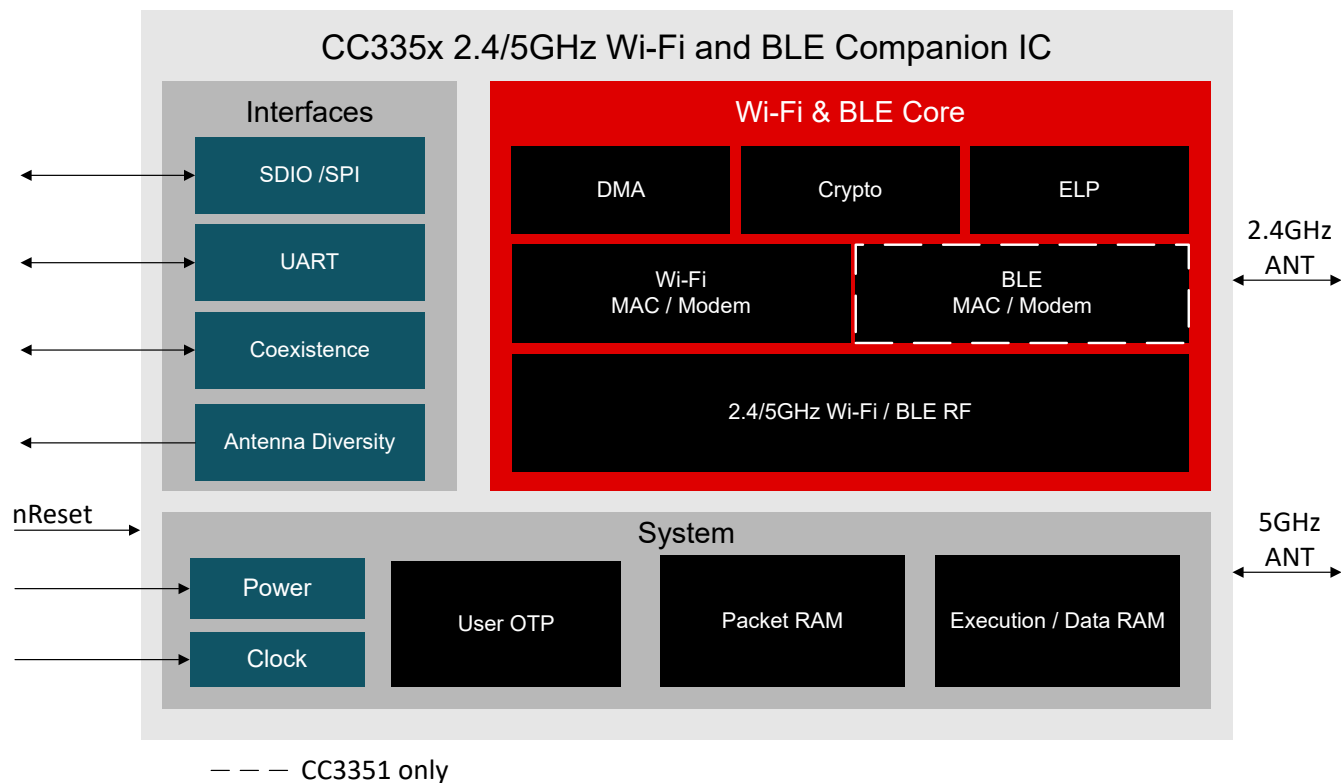


图 4-1. CC3351 系统简图

内容

1 特性.....	1	7.2 器件命名规则样板文件.....	9
2 应用.....	1	7.3 工具与软件.....	9
3 说明.....	2	7.4 文档支持.....	10
4 系统图.....	3	7.5 支持资源.....	10
5 引脚配置和功能.....	5	7.6 商标.....	10
5.1 引脚图.....	5	7.7 静电放电警告.....	10
5.2 引脚属性.....	6	7.8 术语表.....	11
6 应用、实施和布局.....	7	8 修订历史记录.....	11
7 器件和文档支持.....	9	9 机械、封装和可订购信息.....	12
7.1 第三方产品免责声明.....	9		

5 引脚配置和功能

5.1 引脚图

图 5-1 展示了 40 引脚 WQFN 封装的引脚分配。

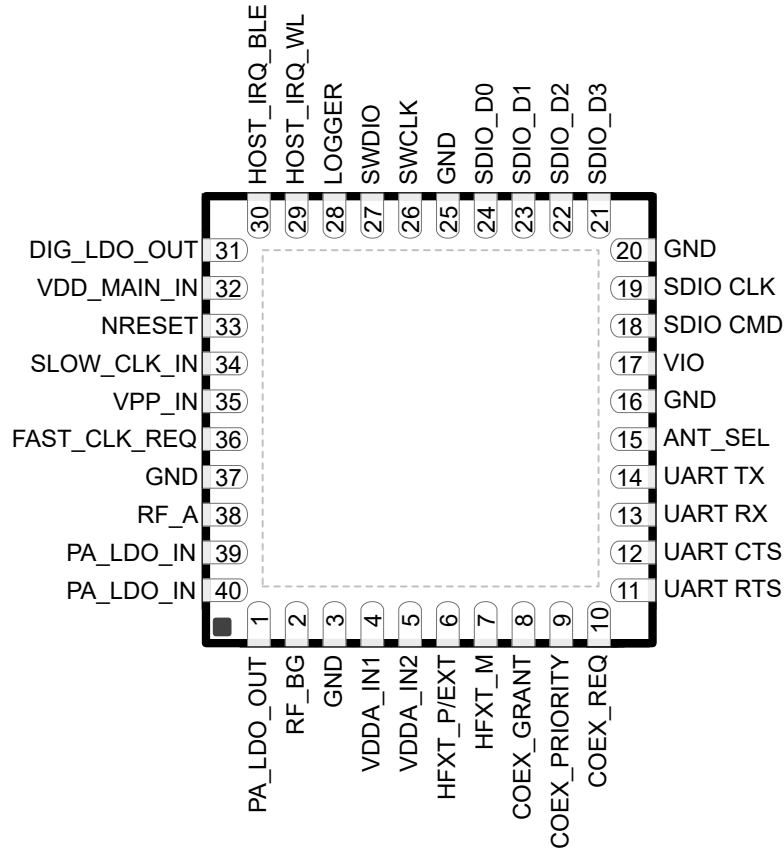


图 5-1. CC3351 引脚图

5.2 引脚属性

表 5-1. 引脚属性

引脚	信号名称	类型	方向 (I/O)	电压电平	关断状态 ¹	上电后状态	说明
1	PA_LDO_OUT	模拟					射频功率放大器 LDO 输出
2	RF_BG	RF	I/O				低功耗蓝牙和 WLAN 2.4GHz 射频端口
3	GND	GND					GND
4	VDDA_IN1	POW					用于模拟域的 1.8V 电源
5	VDDA_IN2	POW					用于模拟域的 1.8V 电源
6	HFX_T_P	模拟		正弦			XTAL_P
7	HFX_T_M	模拟					XTAL_N
8	COEX_GRANT ²	数字	O	V _{IO}	PD	PD	外部共存接口 - 授权
9	COEX_PRIORITY ²	数字	I	V _{IO}	PU	PU	外部共存接口 - 优先级
10	COEX_REQ ²	数字	I	V _{IO}	PU	PU	外部共存接口 - 请求
11	UART RTS	数字	O	V _{IO}	PU	PU	器件 RTS 信号 - BLE HCI 的流控制
12	UART CTS	数字	I	V _{IO}	PU	PU	器件 CTS 信号 - BLE HCI 的流控制
13	UART RX	数字	I	V _{IO}	PU	PU	用于 BLE HCI 的 UART RX
14	UART TX	数字	O	V _{IO}	PU	PU	用于 BLE HCI 的 UART TX
15	ANT_SEL ²	数字	O	V _{IO}	PD	PD	天线选择控制线路
16	GND	GND					GND
17	VIO	POW					1.8V IO 电源
18	SDIO CMD	数字	I/O	V _{IO}	HiZ	HiZ	SDIO 命令或 SPI PICO
19	SDIO CLK	数字	I	V _{IO}	HiZ	HiZ	SDIO 时钟或 SPI 时钟
20	GND	GND					GND
21	SDIO D3	数字	I/O	V _{IO}	HiZ	PU	SDIO 数据 D3 或 SPI CS
22	SDIO D2	数字	I/O	V _{IO}	HiZ	HiZ	SDIO 数据 D2
23	SDIO D1	数字	I/O	V _{IO}	HiZ	HiZ	SDIO 数据 D1
24	SDIO D0	数字	I/O	V _{IO}	HiZ	HiZ	SDIO 数据 D0 或 SPI POCI
25	GND	GND					GND
26	SWCLK	数字	I	V _{IO}	PD	PD	串行线调试时钟
27	SWDIO	数字	I/O	V _{IO}	PU	PU	串行线调试 I/O
28	LOGGER ³	数字	O	V _{IO}	PU	PU	跟踪程序 (UART TX 调试记录器)

表 5-1. 引脚属性 (续)

引脚	信号名称	类型	方向 (I/O)	电压电平	关断状态 ¹	上电后状态	说明
29	HOST_IRQ_WL ³	数字	O	V _{IO}	PD	0	向主机发送的 WLAN 中断请求
30	HOST_IRQ_BLE ³	数字	O	V _{IO}	PD	PD	向主机发出的 BLE 中断请求 (在共享 SDIO 模式下)
31	DIG_LDO_OUT	模拟	O				数字 LDO 输出到去耦电容器
32	VDD_MAIN_IN	POW					用于 SRAM 和数字的 1.8V 电源输入
33	nRESET	数字	I	V _{IO}	PD	PD	用于启用或禁用器件的复位线路 (低电平有效)
34	SLOW_CLK_IN	数字	I	V _{IO}	PD	PD	32.768kHz RTC 时钟输入
35	VPP_IN	POW					1.8V OTP 编程输入电源
36	FAST_CLK_REQ	数字	O	V _{IO}	PD	PD	来自器件的快速时钟请求
37	GND	GND					GND
38	RF_A	RF					WLAN 5GHz 射频端口
39	PA_LDO_IN	POW					用于 PA 的 3.3V 电源
40	PA_LDO_IN	POW					用于 PA 的 3.3V 电源

1. 根据“关断状态”列，当器件处于带内部 PU/PD 的关断模式时，所有数字 I/O (SDIO 信号除外) 均为高阻态。
2. 有关支持级别，请参阅软件版本说明。
3. LOGGER 和 HOST_IRQ_WL 引脚在启动期间由器件进行检测，请参阅 [CC33xx 硬件集成](#)。

6 应用、实施和布局

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

图 6-1 展示了使用优化物料清单的 CC335x 的参考原理图。

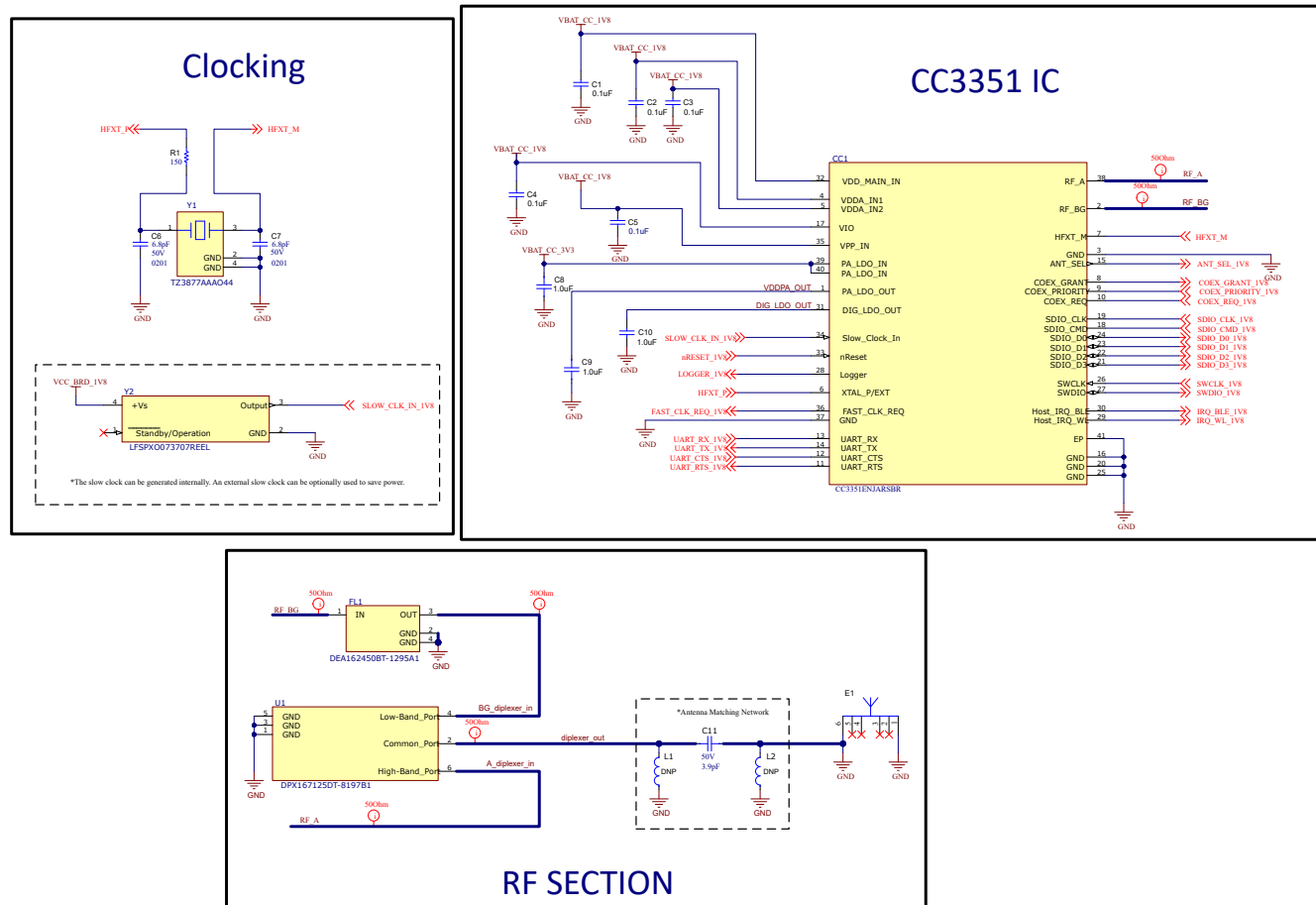


图 6-1. CC335x 参考原理图

1. 可在内部生成慢速时钟。可以选择使用外部慢速时钟以节省电能。
2. 有关天线选择和匹配的更多信息，请参阅 [CC33xx 硬件集成](#)。

7 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

7.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

7.2 器件命名规则样板文件

器件开发演变流程：

X 试验器件不一定代表最终器件的电气规范标准，并且可能不使用生产组装流程。

P 原型器件不一定是最终器件模型，并且不一定符合最终电气标准规范。

无 完全合格的芯片模型的生产版本。

支持工具开发演变流程：

TMDX 还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。

TMDS 完全合格的开发支持产品。

X 和 P 器件和 TMDX 开发支持工具在供货时附带如下免责条款：

器件开发演变流程：

TMX 试验器件不一定代表最终器件的电气规范标准，并且可能不使用生产组装流程。

TMP 原型器件不一定是最终器件模型，并且不一定符合最终电气标准规范。

TMS 完全合格的芯片模型的生产版本。

支持工具开发演变流程：

TMDX 还未经德州仪器 (TI) 完整内部质量测试的开发支持产品。

TMDS 完全合格的开发支持产品。

TMX 和 TMP 器件和 TMDX 开发支持工具供货时附带如下免责条款：

“开发的产品用于内部评估用途。”

生产器件和 TMDS 开发支持工具已进行完全特性描述，并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。

预测显示原型器件 (X 或者 P) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定，故德州仪器 (TI) 建议请勿将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。

7.3 工具与软件

设计套件与评估模块

CC330x 参考设计文件

CC330x 参考设计 CAD 源文件。TI 建议在创建布局时使用此设计作为参考，以实现本数据表中列出的射频性能。

CC3351 BoosterPack 插件模块

CC3301 BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3351) 是一款测试和开发板，可轻松连接到 TI LaunchPad™ 开发套件或处理器板，从而实现快速软件开发。

CC3351 M.2 卡插件模块

CC3351 M.2 卡插件模块 (M2-CC3351) 是测试和开发板，可轻松连接到支持 M.2 Key E 接口的 TI 处理器板或其他处理器板，从而实现快速软件开发。

软件

SimpleLink Wi-Fi 工具箱

SimpleLink Wi-Fi 工具箱是一个用于帮助开发和测试 CC33xx 的工具集。Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能：使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件；执行射频验证测试；为监管认证测试执行预测试；调试硬件和软件平台的集成问题。

CC33xx 器件驱动 程序

CC33XX 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件，适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列软件开发源，旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。

7.4 文档支持

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

应用报告

CC33xx 生产线指 南

Texas Instruments™ 提供了许多资源，可帮助用户快速检查其器件的功能和性能。本文档提供了指导用户进行 CC33xx 生产线测试的必要信息。可使用德州仪器 (TI) 提供的工具和软件来检查器件的功能。由于需要外部设备来进行彻底检查，因此性能测试更为复杂。

SimpleLink CC33xx 安全特性

本文档将介绍 CC33xx 安全相关特性；供应商可以通过一个包含简洁 API、工具和文档的生态系统来利用这些特性

用户指南

CC33xx WLAN 特性用户指南

本文档提供有关 CC33xx 系列器件和 Wi-Fi® 功能以及 TI 专有增强功能的信息。本文档并不提供完整的应用程序编程接口 (API) 集，而是提供对这些特性的简要概述。

CC33xx 硬件集 成

本文档介绍了如何将 CC330x 集成到任何系统中以及该器件的硬件要求。这里还列出了布局和原理图注意事项，TI 强烈建议遵循这些注意事项，以实现本数据表中列出的器件性能。

7.5 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

7.6 商标

SimpleLink™ is a trademark of TI.

is a trademark of TI.

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth Sig, Inc.

is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc..

所有商标均为其各自所有者的财产。

7.7 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

7.8 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

8 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
2024 年 4 月	*	初始发行版

9 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是所指定器件的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

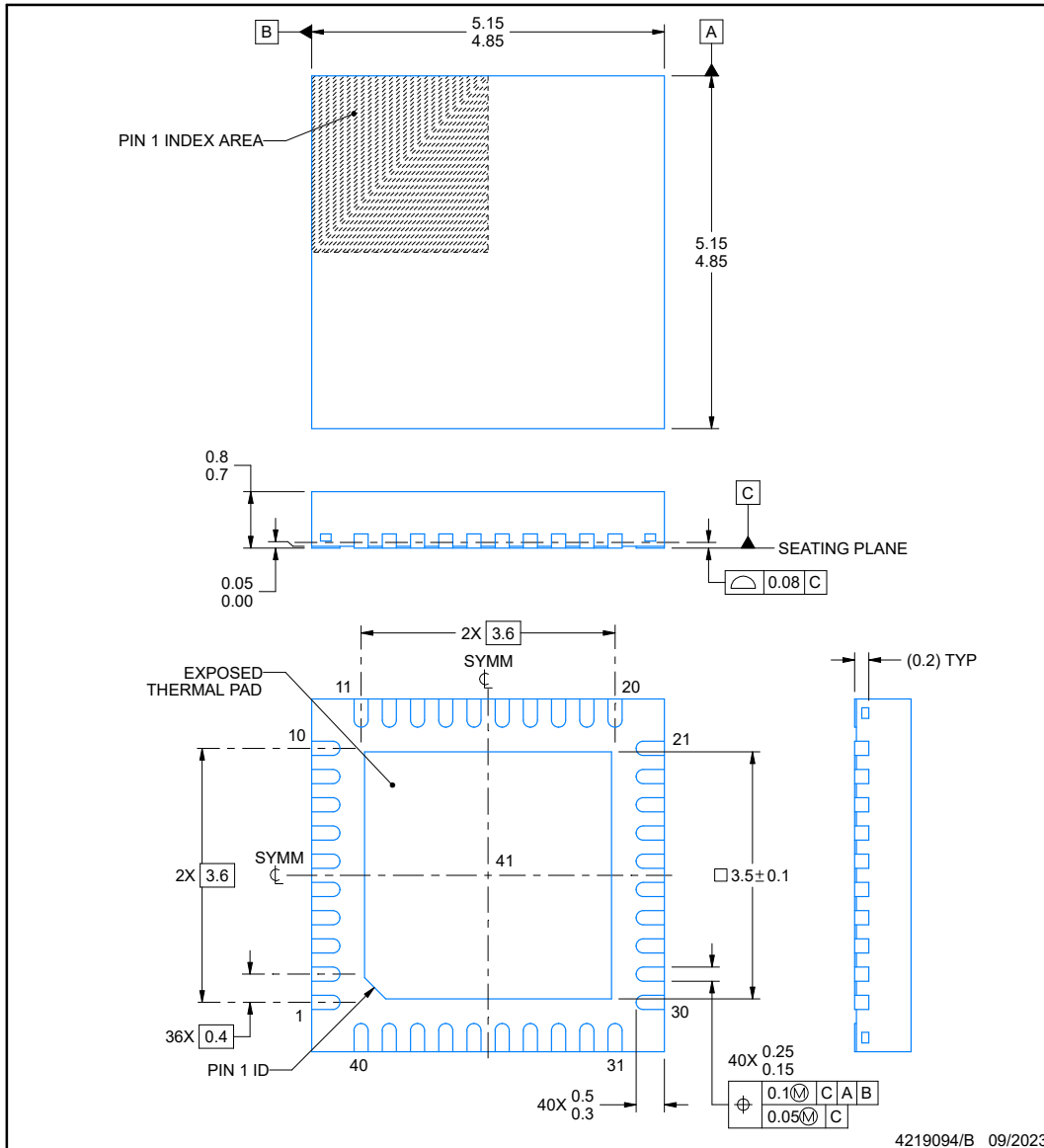


RSB0040B

PACKAGE OUTLINE

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES:

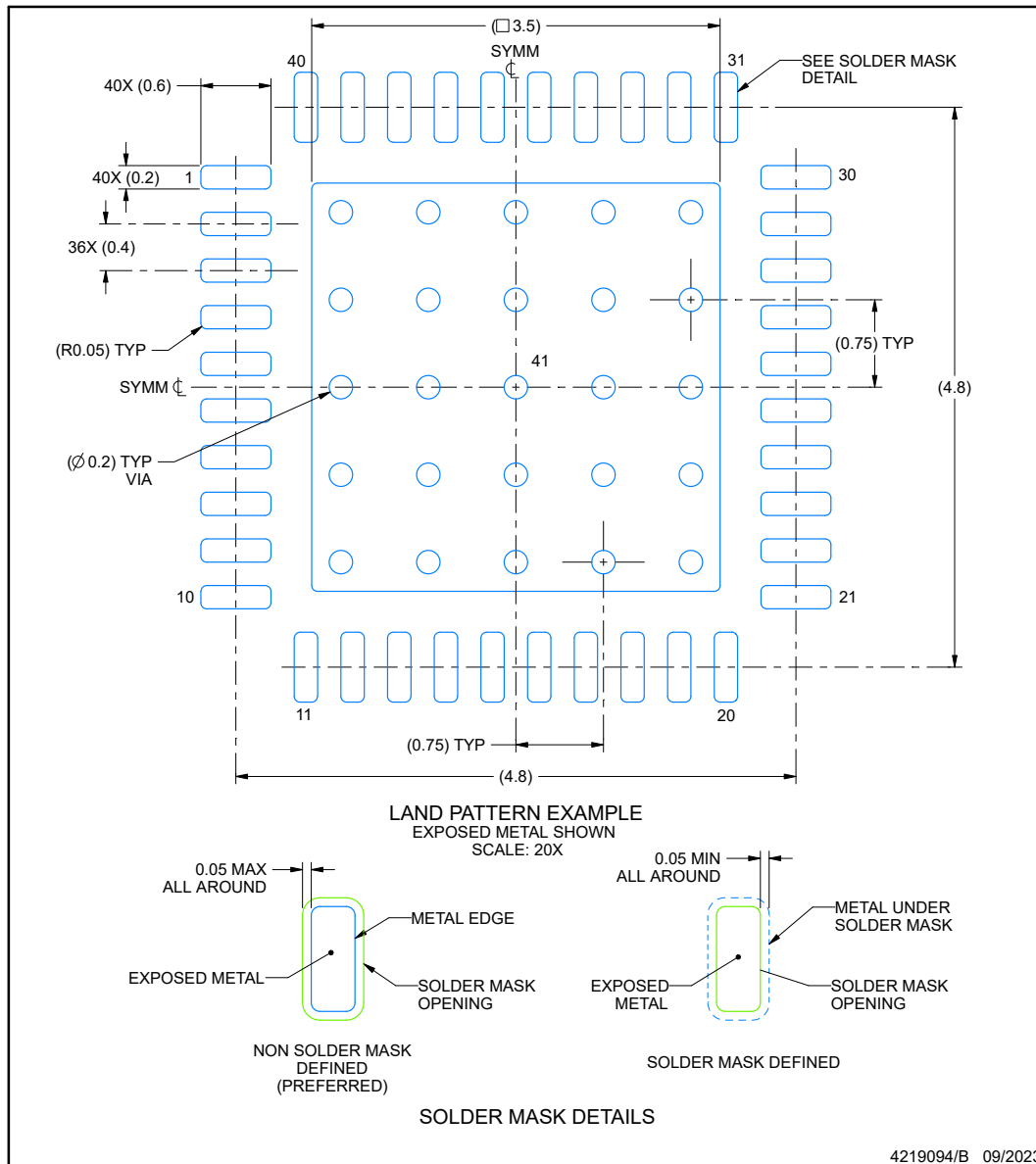
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

RSB0040B

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

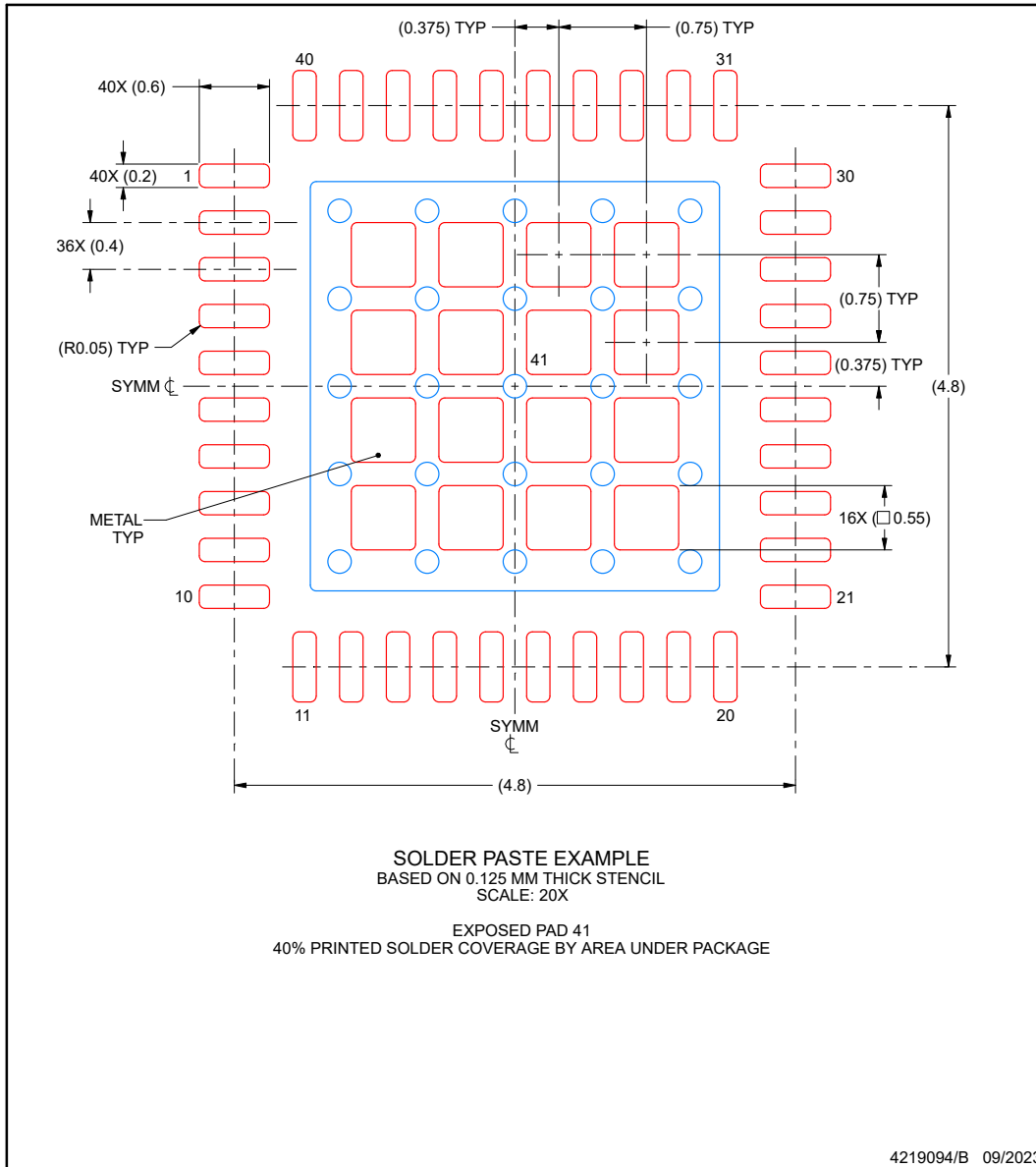
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RSB0040B

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
XCC3350ENJARSBR	ACTIVE	WQFN	RSB	40	3000	TBD	Call TI	Call TI	-40 to 125		Samples
XCC3351ENJARSBR	ACTIVE	WQFN	RSB	40	3000	TBD	Call TI	Call TI	-40 to 105		Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

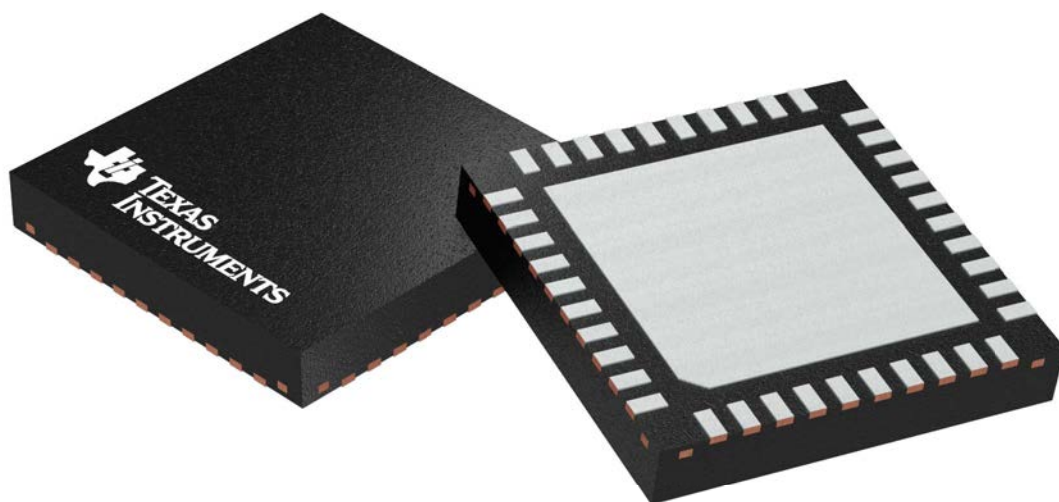
GENERIC PACKAGE VIEW

RSB 40

WQFN - 0.8 mm max height

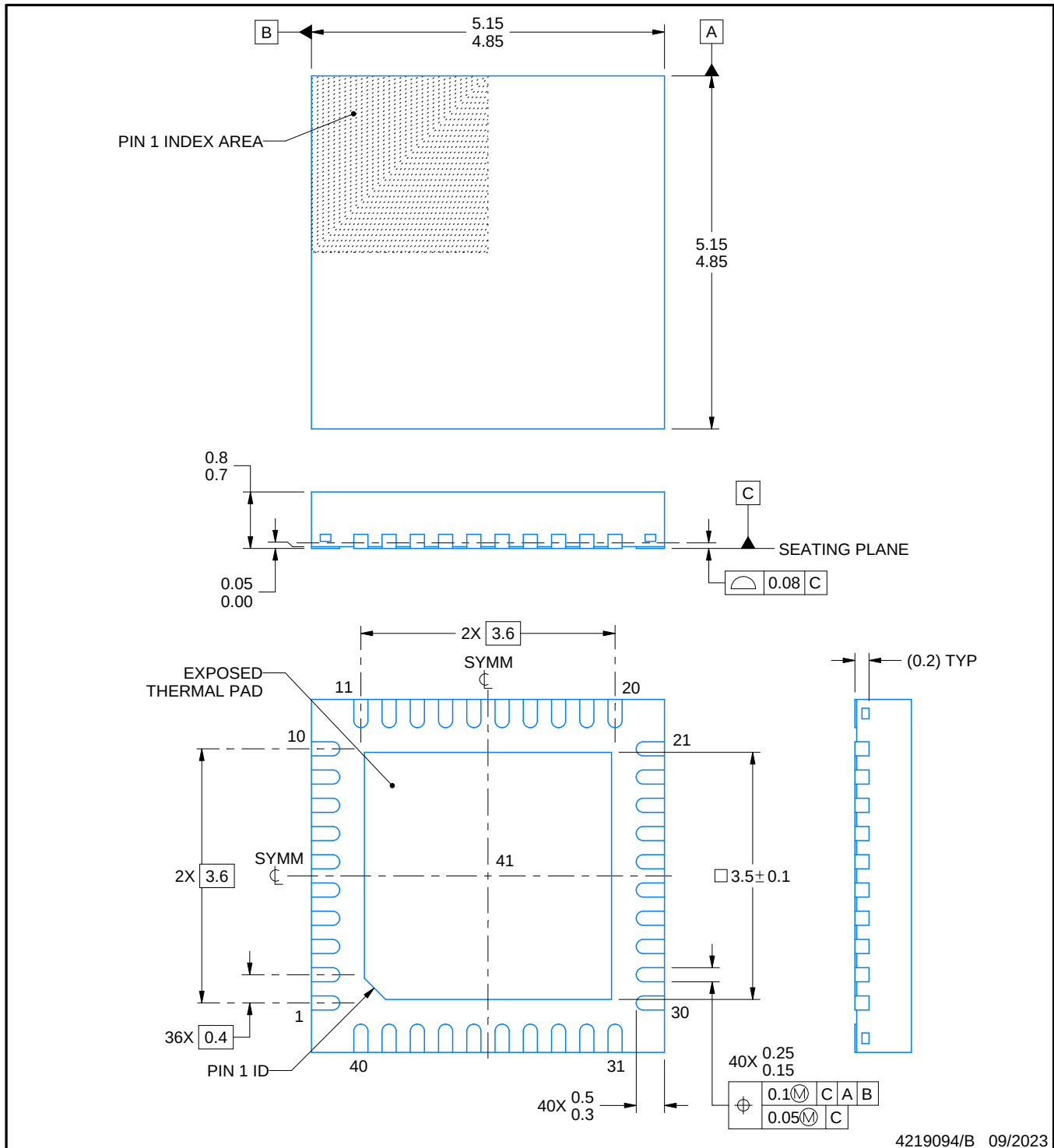
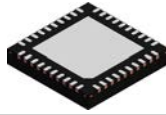
5 x 5 mm, 0.4 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4207182/D



NOTES:

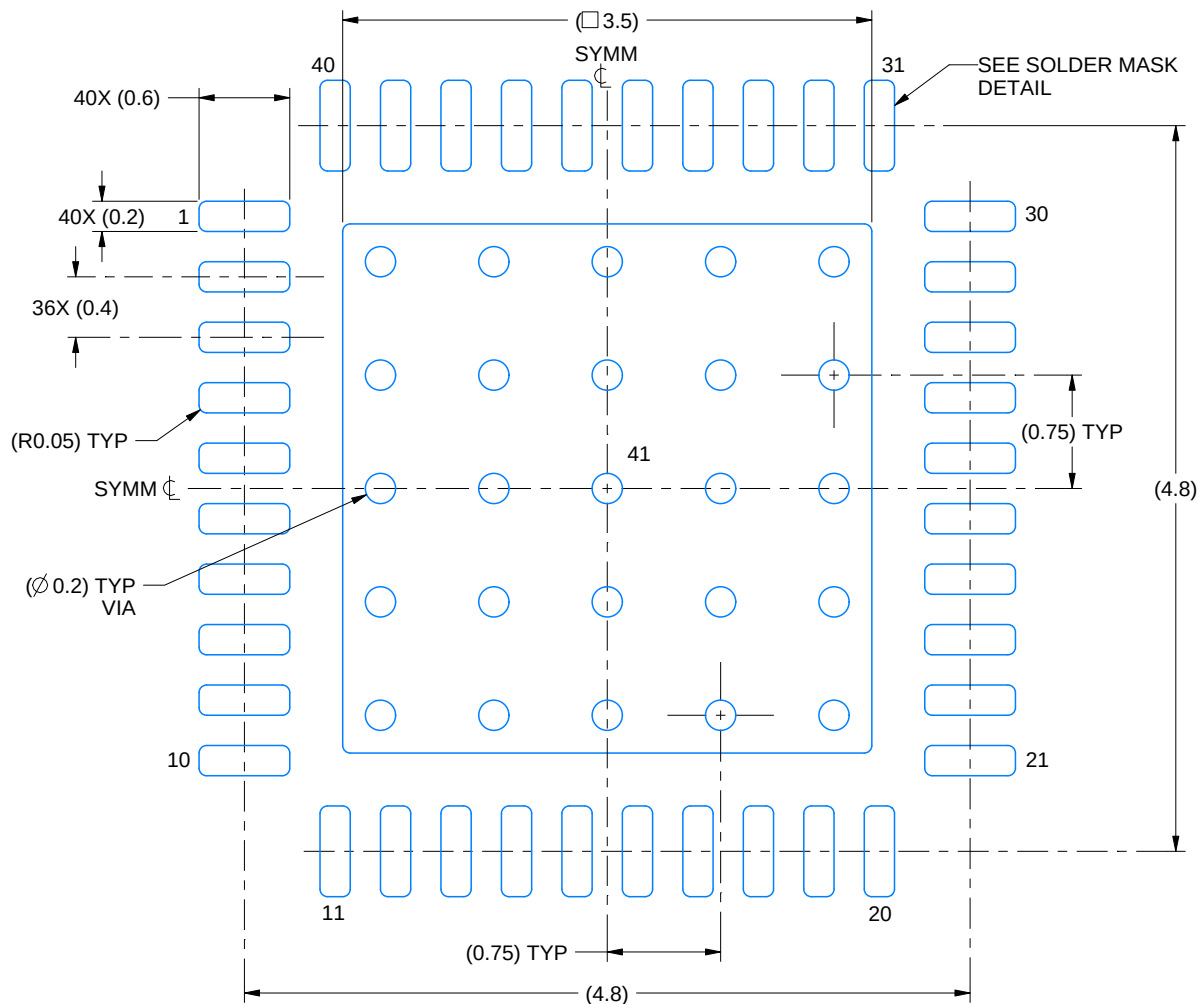
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

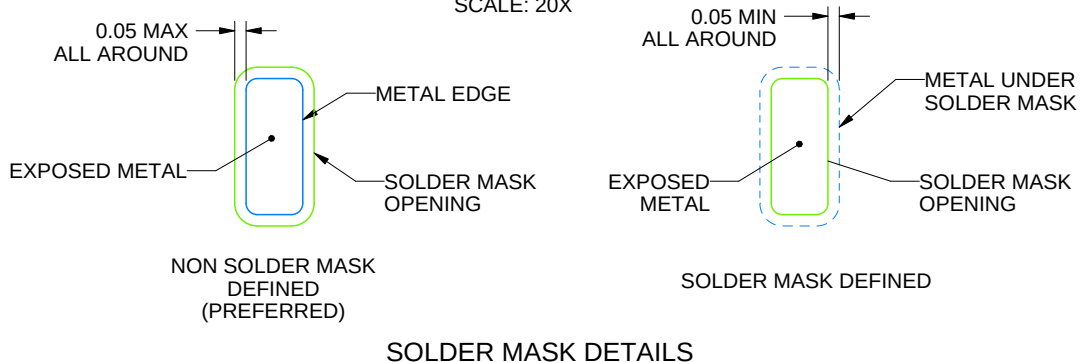
RSB0040B

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



4219094/B 09/2023

NOTES: (continued)

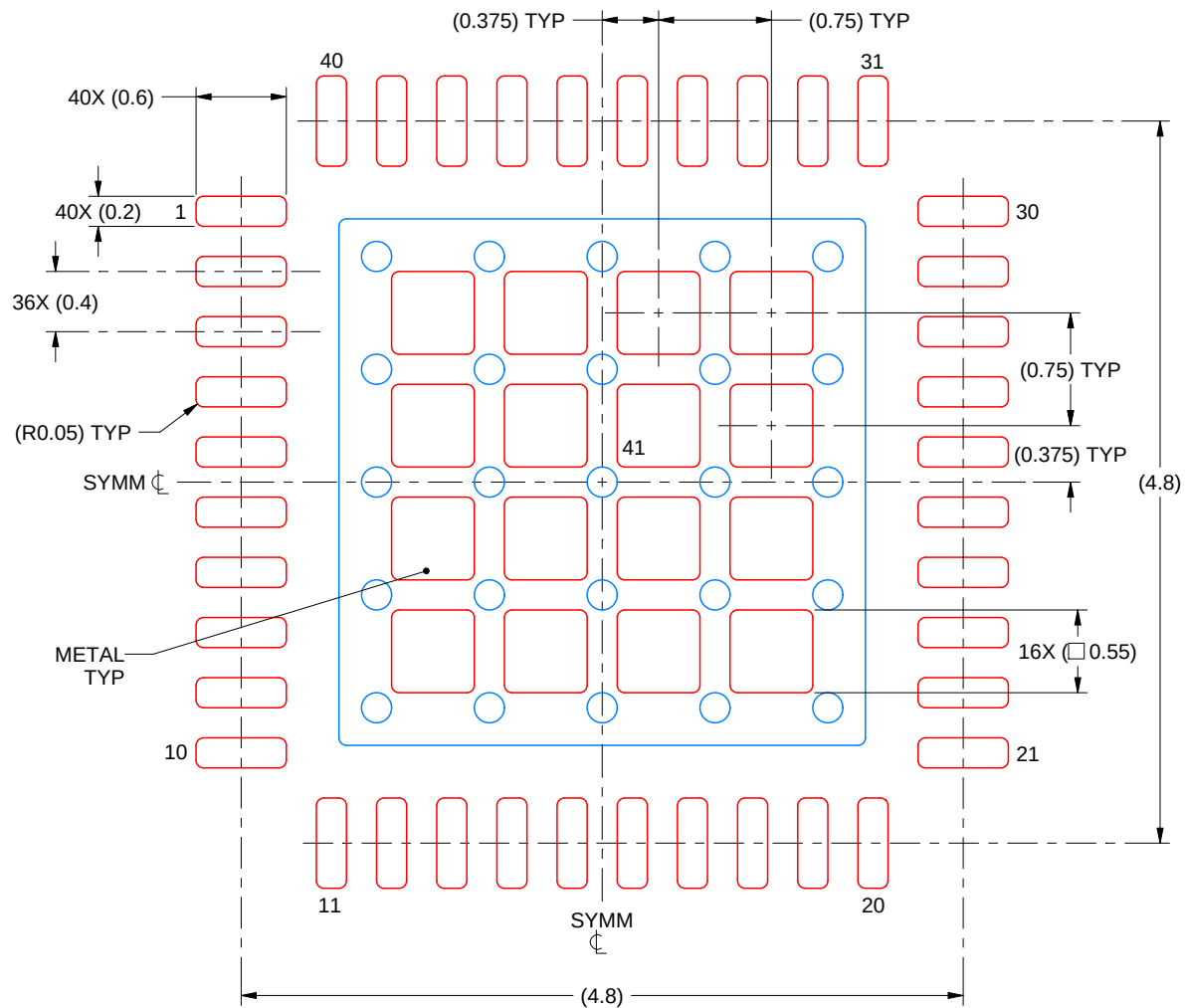
- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RSB0040B

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
 SCALE: 20X

EXPOSED PAD 41
 40% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4219094/B 09/2023

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司